

استفاده از روش لیتوگرافی نرم جهت ایجاد میکروساختارها روی بستر آب دوست شده پلیمر PMMA

علیرضا شمس^۱، دانشجوی دکتری؛ سعید دل آرام فریمانی^۲، کارشناس ارشد؛ احمد عقیفی^۳، استادیار

۱- دانشکده برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - تهران - ایران - a.shamsi89@gmail.com

۲- دانشکده برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - تهران - ایران - saeed_delaram_mut@yahoo.com

۳- دانشکده برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - تهران - ایران - ah_alfifi@iust.ac.ir

چکیده: روش‌های ساخت لیتوگرافی نرم به دلیل سادگی و هزینه پایین و سازگاری مناسب آن‌ها با تولید انبوه امروزه توجه محققین در زمینه ساخت سیستم‌های میکروالکترومکانیکی قرار گرفته‌اند. در این مقاله، روشی مفید و کم‌هزینه برای ایجاد میکرو ساختارها با استفاده از برجسته‌سازی گرم در مواد پلیمری ارائه گردیده است. مهر مورد استفاده برای این کار از جنس پلیمر SU-8 بوده که روی یک زیرلایه شیشه‌ای ساخته شده است. فرآیند حرارتی مورد استفاده در این روش شامل پارامترهای مهمی همچون دما و فشار است که همگی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای اینکه بتوان از ساختار ایجاد شده در ابزارهای میکروسیال استفاده نمود، بستر آب‌گریز PMMA، آب دوست گردیده تا بتوان از آن در ابزارهای میکروسیال استفاده نمود. همچنین در این مقاله ساختارهایی با کمینه ابعاد ۱۵ میکرومتر و ارتفاع ۵۰ میکرومتر ساخته شده‌اند که برای کاربردهای میکروفلوئیدیکی قابل قبول است. ویژگی‌های بارز این روش ساخت، سادگی به دلیل عدم به کارگیری تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و هزینه کم به سبب استفاده از زیرلایه شیشه‌ای برای مهر و ورق‌های پلکسی به عنوان بستر می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: لیتوگرافی نرم، MEMS، SU-8، میکروساختار، PMMA.

Fabrication of Microstructures on a Hydrophilic Modified PMMA Substrate using Soft Lithography Method

A.R Shamsi¹, PhD Student; S. Delaram Farimani², MSc; A. Alfifi³, Assistant Professor

1- Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Maleke Ashtar University of Technology, Tehran, Iran, Email: a.shamsi89@gmail.com

2- Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Maleke Ashtar University of Technology, Tehran, Iran, Email: saeed_delaram_mut@yahoo.com

3- Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Maleke Ashtar University of Technology, Tehran, Iran, Email: ah_alfifi@iust.ac.ir

Abstract: Soft lithography fabrication methods have been used enormously by MEMS researchers in recent years, due to their low cost and simplicity and batch fabrication feasibility. In this paper, a low cost and useful technique to fabricate Microstructures on a polymeric substrate by hot embossing is presented. The used master has been fabricated from SU-8 polymer on a glass substrate. The main parameters of hot embossing quality such as temperature and pressure are discussed and the optimum values are determined. The hydrophobic surface of PMMA substrate is modified to hydrophilic in order to be used in Microfluidic devices. As a good approach, Microchannels by minimum feature size of 15 μ m and depth of 50 μ m are implemented in this paper. Major advantages of this method are simplicity and low cost, because of not-complicated equipment and inexpensive materials for substrate.

Keywords: Soft lithography, MEMS, SU-8, microstructures, PMMA.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

تاریخ اصلاح مقاله: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ و ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

نام نویسنده مسئول: علیرضا شمس

نشانی نویسنده مسئول: ایران - تهران - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشکده برق و الکترونیک.

۱- مقدمه

سیستم‌های میکروالکترومکانیکی در دهه‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و کاربردهای بسیار متنوعی در حوزه‌های الکترونیک، نانویری، فناوری اطلاعات، صنایع شیمیایی و مهم‌تر از همه علوم زیستی پیدا کرده‌اند [۱]. اگرچه در ساخت ادوات MEMS اغلب از سیلیکون و گاهی شیشه به‌عنوان اولین گزینه جهت زیرلایه یاد می‌شود، اما فرآیندهای ساخت پایه سیلیکونی نسبتاً گران بوده و برای محصولات ارزان قیمت با فرآیندهای ساده، مناسب نمی‌باشند. علاوه بر این، سادگی ساخت ادوات پلیمری و عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر و شفافیت و انعطاف‌پذیری مناسب پلیمرها، تمایل برای استفاده از پلیمرها به جای سیلیکون و شیشه را افزایش می‌دهد [۲۱].

مواد پایه سیلیکونی اگرچه از کیفیت سطح خوبی برخوردارند، اما دارای مشکلاتی از جمله عدم شفافیت و شکنندگی هستند. لذا کاربردهای این مواد در حوزه ریزسیالات با محدودیت‌هایی همراه است. از این رو گذر از مواد پایه سیلیکونی به سمت مواد دیگر به‌ویژه پلیمرها، یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. در سال‌های اخیر، تکنیک‌های ساخت بر پایه مواد پلیمری که به‌طور کلی لیتوگرافی نرم نامیده می‌شوند، بیش‌تر مورد توجه بوده‌اند. فرآیندهای ساخت مختلف این تکنیک از جمله میکرو قالب‌گیری تزریقی، ریخته‌گری، برجسته‌سازی گرم^۱ و کنده کاری با لیزر^۲ در بخش Bio-MEMS، آزمایشگاه روی یک مدول^۳، میکروسیستم‌های آنالیز کلی^۴ و سنسورهای شیمیایی بسیار مطلوب هستند [۳]. مواد پلیمری دارای مشخصات فیزیکی و شیمیایی مناسبی بوده (از جمله رسانایی الکتریکی پایین و پایداری شیمیایی بالا) [۲]، قیمت پایینی داشته و تولید انبوه آن‌ها آسان است [۴]. در این میان، برجسته‌سازی گرم را می‌توان به‌عنوان جایگزین مناسبی برای پروسه‌های سیلیکونی جهت ایجاد طرح‌های میکرونی به کار برد [۳]. به‌طور کلی، برجسته‌سازی گرم عبارت است از مهرزنی الگوی موردنظر بر روی یک پلیمر، همراه با افزایش دما به بالاتر از نقطه گذار بستر پلیمری؛ که به دلیل بازدهی مناسب، تولید ارزان و سادگی فرآیند ساخت به‌عنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های ساخت ادوات پلیمری به حساب می‌آید [۱]. در برجسته‌سازی گرم، فرآیندهای میکروماشین‌کاری پیچیده و گران‌قیمت، فقط برای ساخت یک مهر اولیه موردنیاز بوده و هنگامی که مهر ساخته شد، ساخت قطعه موردنظر به راحتی توسط فرآیند برجسته‌سازی گرم، می‌تواند تکرار شود [۶۵].

مهرهای فرآیند برجسته‌سازی گرم بر اساس ماده مورد استفاده در ساخت آن‌ها به دودسته کلی مهرهای سخت و مهرهای نرم تقسیم می‌شوند. مهرهای سخت اغلب سیلیکونی یا فلزی هستند. مهرهای سیلیکونی با روش سونش یونی واکنشی عمیق^۵ (DRIE) و تر، سونش می‌شوند. روش DRIE هزینه بالایی داشته و روش سونش تر نیز دیواره‌های ساختار را به صورت زاویه‌دار سونش می‌کند. همچنین گوشه‌های بیرونی مهر شکل نامنظمی خواهند داشت. فرآیند LIGA

نیز نیازمند تجهیزات اشعه x و لوازم گران قیمت است [۶۱]. مهرهای فلزی با روش‌هایی همچون ماشین‌کاری CNC، کنده کاری با لیزر و آب کاری الکتریکی قابل ساخت هستند [۴۱]. ماشین‌کاری CNC محدودیت نسبت عمق به عرض^۶ داشته و علاوه بر ایجاد سطحی ناهموار، کنترل مناسبی روی ابعاد ایجاد شده ندارد. همچنین این ماشین‌ها اغلب قادر به ماشین‌کاری ساختارهایی با ابعاد کم‌تر از ۵۰ میکرومتر نیستند.

کنده کاری با لیزر نیز ناهمواری‌هایی تا چند صد نانومتر به همراه داشته و نیازمند تجهیزات پیچیده است. در این بین، اگرچه آب کاری الکتریکی، سطح هموارتری می‌دهد، اما پرهزینه [۳] و زمان‌بر است [۱].

مهرهای نرم، از مواد پلیمری ساخته شده و می‌توانند تا دماهایی پایین‌تر از T_g خودشان در برجسته‌سازی گرم به کار گرفته شوند [۱]. این روش ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر از دو روش پیشین است. مزیت مهرهای نرم، پایین بودن ضریب انبساط آن‌ها و در نتیجه تنش حرارتی پس‌ماند کم‌تر آن‌ها است [۵]. یکی از مواد مناسب برای ساخت مهر نرم، پلیمر SU-8 است. این پلیمر که محصول شرکت Microchem است، در واقع نوعی فتورزیست منفی است. از آنجایی که SU-8 در غلظت‌های مختلفی توسط شرکت سازنده عرضه می‌شود، لذا با انتخاب SU-8 مناسب و کنترل سرعت چرخش هنگام لایه‌نشانی چرخشی^۷ می‌توان آن را با ضخامت موردنیاز لایه‌نشانی نموده و با انجام فرآیند لیتوگرافی مطلوب، ساختار موردنظر را با ارتفاع مناسب در آن ایجاد نمود [۷].

عامل مهمی که در روش برجسته‌سازی گرم باید در نظر گرفته شود، ضریب انبساط حرارتی مهر و بستر است. این ضریب برای بستر PMMA برابر 55 ppmK^{-1} ، برای مهر SU-8 در حدود 52 ppmK^{-1} و در مهرهای سیلیکونی و شیشه‌ای بین ۲ تا 4 ppmK^{-1} است [۸]. همان‌طور که دیده می‌شود، ضریب انبساط حرارتی مهر SU-8 نزدیک زیرلایه پلیمری است، بنابراین تنش حرارتی پس‌ماند کم‌تری بین زیرلایه و مهر SU-8 به وجود آمده که باعث جدایی آسان مهر از زیرلایه پلیمری شده و در نتیجه آسیب کم‌تری به مهر و زیرلایه پلیمری می‌رسد [۹۲].

مزیت دیگر مهرهای SU-8 هموارتر بودن سطح آن‌ها نسبت به نوع سیلیکونی است؛ که در برخی از ابزارهای میکروفولوپدیکی ممکن است نقش مهمی ایفا نماید. به‌عنوان مثال، وجود ناهمواری در کف میکروساختارها در جداسازی DNA، آشکارسازی را با مشکل مواجه می‌سازد [۹]. جدول (۱) میزان ناهمواری سطح مهر و سطح بستر را برای مهرهای سیلیکونی ساخته شده به روش سونش خشک، سونش مرطوب با KOH و نیز مهرهای SU-8 نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ناهمواری سطح مهرهای SU-8 کم‌تر از مهرهای سیلیکونی است [۶].

سیلیکونی ساخته شده اند [۸، ۱۱] نیز هزینه بالای و فرهای سیلیکونی می بایست مورد توجه قرار گیرد. در حالی که در این مقاله از پلیمر SU-8 برای ساخت مهرها روی زیرلایه شیشه ای استفاده شده است که تنها نیاز به لایه نشانی چرخشی و نوردهی اشعه ماورای بنفش دارد. لذا در عین سادگی، هزینه ساخت بسیار کمتری دارد. همچنین کمترین ابعاد ایجاد شده در این مقاله ۱۵ میکرون است که با توجه به اطلاعات ذکر شده در جدول ۲ در مقایسه با موارد مشابه کم تر است.

در این مقاله، ابتدا روش ساخت مهر مورد نظر با استفاده از پلیمر SU-8 و سپس فرآیند برجسته سازی گرم در دمای بالای ۱۶۰ درجه سلسیوس توضیح داده شده و تصاویری نیز از میکروساختارهای ایجاد شده با این روش نشان داده خواهند شد. در ادامه، به موضوع آبدوست کردن ساختار پلیمری بروش پلاسمای پرداخته خواهد شد. در انتها، عوامل مؤثر بر کیفیت برجسته سازی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

جدول ۲: مروری بر مهرهای ساخته شده برای استفاده در برجسته سازی گرم، مزایا، معایب و ویژگی های مهم آن ها

نقاط ضعف	مزیت ها	هزینه ساخت مهر	کمینه ابعاد ایجاد شده	فناوری مورد استفاده برای ساخت	جنس مهر
- گران قیمت - شکننده بودن مهر	تعداد تکرار پذیری خوب	بسیار بالا	۲۵ میکرون	سونش مرطوب و خشک	سیلیکون [۳، ۹ و ۱۰]
- پرهزینه - نیاز به تجهیزات آب کاری دارد	قابلیت ساخت تعداد زیاد با یک مهر	بالا	۱۰۰ میکرون	آب کاری الکتریکی روی SU-8 با زیرلایه سیلیکونی	نیکل [۲]
- هزینه بیشتر به دلیل زیرلایه سیلیکونی	عمر بیشتر مهر	متوسط	۵۰ تا ۱۰۰ میکرون	لیتوگرافی نوری	SU-8 روی زیرلایه سیلیکونی [۸، ۱۰]
- فرآیند ساخت طولانی و پیچیده - نیاز به چند ماده مانند PDMS و SU-8	ابعاد پایین	بسیار بالا	۱ تا ۳ میکرون	لیتوگرافی نوری و لیتوگرافی نرم در قالب از جنس PDMS	اپوکسی [۳]
- ابعاد نسبتا پایین - هزینه خیلی کم		پایین	۱۵ میکرون	لیتوگرافی نوری	SU-8 روی زیرلایه شیشه ای

۲- فرآیند ساخت مهر

خشک می شوند. سپس با استون شستشو شده و برای اینکه سطح آن ها کاملاً بی آب^۸ شود، به مدت ۲۰ دقیقه تحت دمای ۱۸۰ درجه حرارت داده می شوند [۷].

ضخامت SU-8 مورد نظر برای ایجاد ساختار، ۵۰ میکرون است، بنابراین با توجه به راهنمای ارائه شده توسط شرکت سازنده، از SU-8 نوع ۲۰۲۵ استفاده می شود. طبق دستورالعمل استفاده از SU-8 که توسط شرکت سازنده ارائه شده است، برای دستیابی به ضخامت ۵۰ میکرون، سرعت چرخش در لایه نشانی چرخشی ۲۰۰۰ دور بر دقیقه است. پس از لایه نشانی چرخشی SU-8، نمونه به صورت پلکانی پخت اولیه ۹ داده می شود. برای این منظور، نمونه به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۶۵ درجه سانتی گراد حرارت داده می شود، سپس دما تا ۹۵ سانتی گراد افزایش داده شده و حدود ۲۰ دقیقه در این دما باقی می ماند. پس از اتمام پخت اولیه، نمونه به آرامی خنک می شود تا تنش حرارتی پسماند

جدول ۱: ابعاد ناهمواری های سطح مهر و بستر در سیلیکون و SU-8 [۶]

بستر	مهر	جنس مهر
۳/۱ nm	۴ nm	سونش خشک (DRIE)
۶۸/۳ nm	۷۶/۶ nm	سونش مرطوب با KOH در جهت (110)
۱/۵ nm	۱ nm	سونش مرطوب با KOH در جهت (100)
۰/۷ nm	۰/۵ nm	SU-8

مهرهای ساخته شده به روش های مختلف برای استفاده در برجسته سازی گرم به طور خلاصه در جدول ۲ بررسی شده و ویژگی های مهم آن ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. در این مقاله از مهرهای SU-8 برای برجسته سازی گرم جهت ساخت میکروساختارهایی بروی بستری از جنس پلیمر PMMA استفاده شده است. اگرچه مهرهای سیلیکونی (با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۲) در بسیاری موارد مورد استفاده قرار گرفته اند [۹، ۱۰]، اما ساخت آن ها نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته (از قبیل DRIE) داشته و هزینه بر است. همچنین در مهرهای دیگری که با استفاده از SU-8 روی یک زیر لایه

ادوات میکروالکترومکانیکی و نیز قطعات میکروفولوییدیکی ساخته شده بر روی بسترهای PMMA برای کاربردهای پزشکی و شیمی تجزیه را به وجود خواهد آورد [۱۷-۱۴]. چراکه مواد پلیمری استفاده شده در برجسته سازی گرم، بسیار ارزان تر از ویفر سیلیکون بوده و فرآیندهای میکروماشین کاری پیچیده، فقط برای ساخت یک مهر اولیه نیاز است.

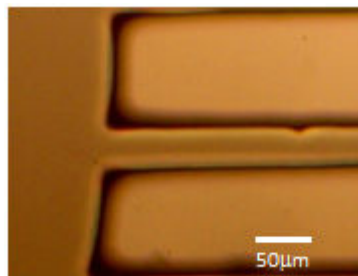
هنگامی که مهر ساخته شد، ساختار موردنظر به راحتی توسط فرآیند برجسته سازی گرم، می تواند تکرار شود [۴]. اما با روش ارائه شده در این مقاله ساخت مهرها نیز فرآیند چندان پیچیده ای نداشته و به دلیل استفاده از زیرلایه شیشه ای برای مهر، هزینه تولید مهر نیز بسیار کاهش می یابد. ایجاد ساختار با پلیمر SU-8 تنها نیاز به دستگاه لایه نشانی چرخشی^{۱۳} برای لایه نشانی SU-8 و دستگاه لیتوگرافی برای تابش UV دارد. به دلیل یک مرحله ای بودن لیتوگرافی، ساخت این مهرها نیازی به تنظیم دقیق^{۱۴} نیز ندارد.

در این مقاله از پلیمر PMMA به عنوان بستر استفاده شده است. همان طور که اشاره شد، در برجسته سازی گرم از اعمال فشار و حرارت برای انتقال طرح مهر بر روی زیر لایه استفاده می شود. دمای لازم برای انجام فرآیند باید بالاتر از T_g زیرلایه PMMA و کم تر از T_g مهر SU-8 باشد تا در حین فرآیند، PMMA انعطاف پذیر بوده و مهر کاملاً سخت و بدون تغییر شکل بماند. مقادیر این دماها برای PMMA و SU-8 نوردهی شده به ترتیب در حدود ۱۰۵ و ۲۴۰ درجه است [۳، ۴]. بنابراین تنظیم دما در انجام این فرآیند نقش به سزایی دارد. فشار اعمالی حین فرآیند نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده و با افزایش دما و فشار میزان دقت افزایش می یابد. اما از طرفی افزایش دما اغلب موجب افزایش تنش حرارتی پسماند شده و باعث بروز چسبندگی در زمان جداسازی مهر از زیرلایه PMMA می گردد [۶]. اما با توجه به اینکه مهر انتخاب شده خود نوعی پلیمر است و ضریب انبساط حرارتی آن بسیار نزدیک به بستر PMMA است، لذا تنش حرارتی پسماند بسیار کم بوده و مشکلی برای افزایش دما وجود ندارد. به همین دلیل دمای فرآیند برجسته سازی گرم ۱۶۰ درجه سانتی گراد انتخاب می شود. بدین ترتیب دیگر نیازی به اعمال فشار زیاد نبوده و فشار اعمال شده برای این فرآیند ۱/۲ مگاپاسکال است.

برای این منظور، ابتدا مهر و بستر پلیمری به یکدیگر متصل شده و تحت فشار ۰/۱ مگاپاسکال وارد فر می شوند. با افزایش تدریجی دما، از دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد به تدریج فشار را نیز افزایش داده تا به ۱/۲ مگاپاسکال برسد. سپس ساختار به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد باقی می ماند تا ساختار مهر به خوبی بر روی بستر منتقل شود. بعد از کاهش دما تا ۹۰ درجه سانتی گراد فشار از روی ساختار برداشته شده و جداسازی^{۱۵} صورت می گیرد. بعد از خنک شدن سیستم، مهر و بستر به راحتی از هم جدا می شوند [۱۸]. تصویر میکروسکوپ روبش الکترونی (SEM^{۱۶}) از ساختار ایجاد شده توسط

تا حد امکان کاهش پیدا کرده [۱۲] و چسبندگی SU-8 به سطح زیرلایه بهبود یابد. در مرحله بعد، نمونه پخت خورده در معرض نوردهی با ماسک طراحی شده قرار گرفته و برای مدت ۶۰ ثانیه نور UV به آن تابیده می شود.

در فرآیند برجسته سازی گرم، ماسک منفی طرح، بر روی مهر ایجاد می شود، در این صورت پس از انتقال طرح از مهر بر روی زیرلایه، ساختار موردنظر بر روی زیرلایه ایجاد خواهد شد. از آنجایی که SU-8 یک فتورزیست منفی است، پس از نوردهی، بخش هایی که در معرض نوردهی قرار گرفته اند باقی خواهند ماند و باقی بخش ها در محلول ظهور حل خواهند شد. طبق دستورالعمل استفاده از SU-8، پس از نوردهی، به نمونه باید یک مرحله پخت بعد از نوردهی^{۱۰} داده شود که جهت تکمیل اتصالات عرضی^{۱۱} در نواحی نورخورده صورت می گیرد [۷]. برای این منظور، ابتدا نمونه از دمای محیط تا دمای ۶۵ درجه سانتی گراد گرم شده و به مدت ۳۰ دقیقه باقی می ماند و سپس در دمای ۹۵ سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه پخت داده شده و در نهایت نمونه به آرامی سرد می شود. پس از آن نمونه برای مدت ۷ دقیقه در محلول ظهور SU-8 قرار می گیرد تا قسمت هایی که در معرض نور قرار نداشتند، حذف شده و ساختار موردنظر ظاهر می شود. در مرحله آخر، جهت افزایش استحکام ساختار و از بین رفتن ترک های موجود بر روی آن، ساختار به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۱۷۰ الی ۱۸۰ درجه حرارت داده می شود. تصویر میکروسکوپی از نمونه مهر ساخته شده با SU-8 در شکل ۱ نشان داده شده است.

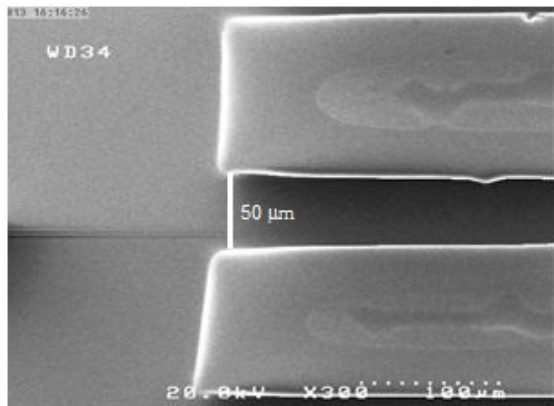


شکل ۱: تصویر میکروسکوپ نوری از مهر ساخته شده با پلیمر SU-8

۳- فرآیند برجسته سازی گرم

به طور کلی فرآیند برجسته سازی گرم شامل سه مرحله اصلی است. در مرحله اول، مهر و زیرلایه پلیمری تا دمای بالاتر از دمای گذار^{۱۲} زیرلایه پلیمری (T_g) گرم می شوند. دمای گذار، دمایی است که پلیمر از حالت شیشه ای خارج شده و نرم و انعطاف پذیر می شود. در مرحله دوم، مهر تحت یک فشار از پیش تنظیم شده، بر روی زیرلایه فشرده می شود تا الگوی ایجاد شده روی مهر، بر روی زیرلایه پلیمری منتقل شود. در مرحله آخر، پس از سپری شدن مدت زمانی از فشردن مهر بر روی زیرلایه، سیستم تا دمایی پایین تر از T_g سرد شده و زیرلایه و مهر از یکدیگر جدا می شوند [۱]. این فرآیند می تواند جایگزین مناسبی برای فرآیندهای سیلیکونی بوده و امکان ساخت انبوه و ارزان سیستم ها و

- همانندسازی^{۲۱}
- عمق ساختار ایجاد شده
- عمود بودن دیواره حفره‌ها (نسبت عمق به عرض)
- مینیمم ابعاد طرح ایجاد شده
- میزان آسیب وارده به مهر



شکل ۲: تصویر SEM از میکروساختارهای ایجاد شده

برجسته‌سازی به ازای دماها و فشارهای مختلفی انجام گرفته و کیفیت میکروساختارهای ایجاد شده با توجه به معیارهای فوق مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

۵-۱- تأثیر میزان دما و فشار حین فرآیند برجسته‌سازی

اگر دمای فرآیند کمتر از حد مورد نیاز باشد، بستر PMMA به اندازه کافی نرم و حالت پذیر نشده و طرح مورد نظر با عمق مناسب درون آن ایجاد نخواهد شد. از طرف دیگر به دلیل سخت بودن بستر، با اعمال فشار، مهر دچار آسیب خواهد شد. علاوه بر این، نسبت طول به عرض ساختار ایجاد شده نیز قابل قبول نبوده و دیواره‌هایی منحنی‌وار ایجاد خواهند شد [۶]. با افزایش بیش از حد دمای فرآیند، استحکام مهر نیز کمتر شده و مهر آسیب خواهد دید.

در این مقاله با کنترل فرآیند افزایش و کاهش دما و نیز کاهش سرعت تغییرات دمایی، از آسیب دیدن مهر و ایجاد تنش حرارتی پسماند مابین مهر و زیرلایه جلوگیری شده است.

عامل دیگری که بر کیفیت برجسته‌سازی مؤثر است، فشار اعمالی حین فرآیند است. اگر فشار اعمالی بیش از حد زیاد باشد، احتمال آسیب دیدن مهر وجود دارد. از طرف دیگر، با کاهش فشار، بستر پلیمری که در اثر حرارت نرم شده است، نمی‌تواند به خوبی در فضاهای خالی مهر جاری شود و در نتیجه الگوی مورد نظر با عمق لازم بر روی بستر ایجاد نخواهد شد [۶]. در این بخش، مؤلفه‌های کیفی برجسته‌سازی به ازای فشارها و دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آزمایش‌های فوق در جدول ۳ آمده‌اند. با توجه نتایج ذکر شده در جدول، بهترین

فرآیند برجسته‌سازی گرم، در شکل ۲ نشان داده است. عرض ساختارهای ایجاد شده در این شکل ۵۰ میکرومتر است.

۴- آب‌دوست نمودن سطح پلیمر

ورق‌های PMMA مورد استفاده در این مقاله به طور ذاتی آب‌گریز می‌باشند. اما با توجه به این‌که میکروساختارهای پلیمری به‌ویژه ابزارهای میکروفلوئیدی عمدتاً جهت استفاده در علوم زیستی ساخته می‌شوند [۴]. آب‌دوست بودن سطح پلیمر تأثیر بسزایی در کارایی این ابزارها دارد. به عنوان مثال، میزان جذب ناخواسته پروتئین در سطح آب‌گریز بسیار بیشتر از سطح آب‌دوست است [۱۹]. از این رو، آب‌دوست نمودن سطح میکروساختار ایجاد شده امری ضروری به نظر می‌رسد.

تاکنون روش‌های متنوعی برای آب‌دوست نمودن سطح پلیمرها ارائه گردیده است. از جمله می‌توان به تابش با لیزر اگزایمر در خلا^{۱۷} [۲۰]، لایه‌نشانی فاز بخار مواد آلی [۲۱]، آمینولیزه کردن^{۱۸} [۲۲] و فعال‌سازی با پلاسما^{۱۹} [۲۳] اشاره نمود. در این مقاله از روش کنده کاری با پلاسما^{۲۰} بهره گرفته شده است. به نحوی که سطح پلیمر در دستگاه لایه‌نشانی حرارتی سرب (ساخت شرکت یارنیکان) به مدت پانزده دقیقه با توان ۱۰۰ وات در معرض تابش پلاسما قرار گرفته و پس از آن آب‌دوست می‌شود. پلاسمای مورد استفاده در این مقاله پلاسمای اکسیژن بوده است که غالباً برای فعال کردن سطح پلیمرهایی از قبیل PDMS به کار می‌رود.

همان‌طور که می‌دانیم، پلاسما حاوی ذرات باردار پرانرژی است. هنگامی که این ذرات پرانرژی به سطح ماده پلیمری برخورد می‌کنند باعث شکسته شدن پیوندهای بین اتم‌های سطحی شده و رادیکال‌های سطحی را به وجود می‌آورند. مجاورت این رادیکال‌ها با مولکول‌های آب ایجاد گروه‌های قطبی هیدروکسیل را به همراه داشته و در نهایت نیروی جاذبه بین مولکول‌های آب و سطح پلیمر را افزایش می‌دهد [۲۴]. البته در صورتی که توان پلاسمای ایجاد شده بیش از حد مورد نیاز باشد، برخورد ذرات باردار به سطح، موجب سونش سطح پلیمر خواهد شد. لذا توان انتخابی در حدی است که تنها باعث شکسته شدن پیوندهای سطحی شود.

۵- بحث و نتایج

کیفیت مناسب برجسته‌سازی منوط به کنترل عوامل مؤثر در فرآیند است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از دما، فشار و مدت‌زمان فرآیند حرارت‌دهی [۶]. در این بخش هر یک از این عوامل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. زمان برجسته‌سازی باید به حدی باشد تا بستری که در اثر حرارت نرم شده است، فرصت کافی برای جاری شدن در فضای بین برجستگی‌های مهر را داشته و شکل مناسب را به خود بگیرد. در این مقاله، برای اینکه فرصت فوق برای بستر فراهم شود، مدت‌زمان حرارت‌دهی را ۲۰ دقیقه انتخاب نمودیم. برای بررسی اثر دما و فشار، معیارهایی برای سنجش کیفیت برجسته‌سازی تعریف شده‌اند که عبارت‌اند از:

- [5] Harsonl, H.J. Lu, Y.C. Liu, Y.C. Lam, and X.C. Shan, "Experimental studies on polymer deformation and flow in micro hot embossing," *Electronics Packaging Technology Conference, 8th*, Singapore, EPTC '06, 2006.
- [6] M.B. Esch, S. Kapur, G. Irizarry, and V. Genova, "Influence of master fabrication techniques on the characteristics of embossed microfluidic channels," *Lab Chip*, vol. 3, pp. 121-127, 2003.
- [7] Available online at: www.microchem.com, Jan. 2013.
- [8] K. Metwally, L. Robert, R. Salut, and Chantal Khan Malek, "SU-8-based rapid tooling for thermal roll embossing," *DTIP, Aix-en-provence*, pp. 11-13, France, 2011.
- [9] M.B. Esch, SahilKapur, G. Irizarry, and V. Genova, "Influence of master fabrication techniques on the characteristics of embossed microfluidic channels," *Lab Chip*, vol. 3, pp. 121-127, 2003.
- [10] J.M. Li, C. Liu, X.D. Dai, H.H. Chen, Y. Liang, H.L. Sun, H. Tian, and X.P. Ding, "PMMA microfluidic devices with three-dimensional features for blood cell filtration," *J. of Micromech. Microeng.* vol. 18, 2008.
- [11] A. Mathur, S.S. Roy, M. Tweedie, S. Mukhopadhyay, S.K. Mitra, and J.A. McLaughlin, "Characterization of PMMA microfluidic channels and devices fabricated by hot embossing and sealed by direct bonding," *Current Applied Physics*, vol. 9, pp. 1199-1202, 2009.
- [12] S. Grist, J.N. Patel, M. Haq, B.L. Gray, and B. Kaminska, "Effect of surface treatments/coatings and soft bake profile on surface uniformity and adhesion of SU-8 on a glass substrate," *Proceedings of the SPIE*, vol. 93, pp. 75930F-1-75930F-9, 2010.
- [13] X. Mao, et al., "Two new methods to improve the lithography precision for SU-8 photoresist on glass substrate," *MEMS Conference*, Paris, France, pp. 337-340, 2012.
- [14] G.B. Lee, et al., "Micro-fabricated plastic chips by hot embossing methods and their applications for DNA separation and detection sensors actuators," *B75*, pp. 142-148, 2001.
- [15] H. Becker, et al., "Microfluidic devices for μ -TAS applications fabricated by polymer hot embossing," *Proc. SPIE 3515*, pp. 82-177, 1998.
- [16] H. Becker, and U. Heim, "Hot embossing as a method for the fabrication of polymer high aspect ratio structures," *Sensors Actuators A 83*, pp. 130-517, 2000.
- [17] H. Becker, and U. Heim, "Silicon as tool material for polymer hot embossing," *Proc. MEMS 99*, pp. 228-231, 1999.

[۱۸] علیرضا شمسی، علی امیری، سعید دلارام فریمانی، حسن حاجقاسم، منصور محتشمی فر و مجیدرضا علی احمدی، «ساخت میکروکانال با استفاده از فرآیند برجسته‌سازی گرم»، صنایع الکترونیک، دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲.

- [19] K.L. Prime, and G.M. Whitesides, "Self-assembled organic monolayers: model systems for studying adsorption of proteins at surfaces," *Science*, vol. 252, pp. 1164-1167, 1991.
- [20] A. Hozumi, T. Masuda, K. Hayashi, H. Sugimura, O. Takai, and T. Kameyama, "Spatially defined surface modification of poly (methyl methacrylate) using 172 nm vacuum ultraviolet light," *Langmuir*, vol.18, no. 23, pp. 9022-9027, 2002.
- [21] A. Hiratsuka, H. Muguruma, K.H. Lee, et al., "Organic plasma process for simple and substrate-independent surface modification of polymeric Bio-MEMS devices," *Biosens Bioelectron*, vol. 19, pp. 1667-1672, 2004.

برجسته‌سازی در فشار ۱/۲ مگاپاسکال و دمای ۱۶۰ درجه سلسیوس صورت می‌گیرد.

جدول ۳: مقایسه کیفیت نمونه‌های ساخته‌شده به ازای دماها و فشارهای

مختلف

فشار (دما) (MPa) (°C)	90	105	120	140	160	180
0.2	▼	▾	▾	▾	▾	▾
0.5	▾	▾	▾	▾	▾	▾
0.8	▾	▾	▾	▾	▾	▾
1	▾	▾	▾	▾	▾	▾
1.2	▾	▾	▾	▾	▾	▾
1.5	▾	▾	▾	▾	▾	▾

۶- نتیجه‌گیری

در این مقاله با استفاده از روش لیتوگرافی نرم، با ساخت مهری جدید و کم‌هزینه که برای برجسته‌سازی گرم بسیار مفید است، میکروساختارهایی بر روی یک بستر پلیمری از جنس PMMA ساخته شدند. مهر موردنظر از جنس پلیمر SU-8 و روی زیرلایه شیشه‌ای ساخته‌شده و به دلیل عدم استفاده از زیرلایه سیلیکونی و بی‌نیازی به فرایندها و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در مقایسه با موارد مشابه ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

همچنین با توجه به آب‌گریز بودن بستر PMMA، با به‌کارگیری روش کنده‌کاری با پلاسما، سطح پلیمر آب‌دوست گردیده است. مدت‌زمان برجسته‌سازی، دما و فشار اعمال‌شده از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کیفیت برجسته‌سازی هستند. فرآیند ساخت برای دماها و فشارهای مختلفی انجام گرفته و مقادیر بهینه آن‌ها به ترتیب برابر ۱۶۰ درجه و ۱/۲ مگا پاسکال به دست آمده‌اند. ساختارهای ساخته‌شده در این مقاله دارای کمینه ابعاد ۱۵ و عمق ۵۰ میکرون می‌باشند که در مقایسه با موارد مشابه بهبود چشم‌گیری پیدا کرده است.

مراجع

- [1] Y. Fan, T. Li, W. Lau, and J. Yang, "A rapid hot-embossing prototyping approach using SU-8 molds coated with metal and anti-stick coatings," *Micro-electro-mechanical Systems*, vol. 21, no. 4, pp. 875-881, 2012.
- [2] S.C. Chen, M.C. Lin, R.D. Chien, and W.L. Liaw, "Hot embossing of micro-featured devices," *International Conference on Mechatronics*, Taipei, Taiwan, 2005.
- [3] T. Koerner, L. Brown, R. Xie, and R.D. Oleschuk, "Epoxy resins as stamps for hot embossing of microstructures and microfluidic channels," *Sensors and Actuators B*, vol. 107, pp. 632-639, 2005.
- [4] Y. Zhao, and T. Cui, "Fabrication of high-aspect-ratio polymer-based electrostatic comb drives using the hot embossing technique," *J. Micromech. Micro Eng.*, vol. 13, pp. 430-435, 2003.

- [22] A.C. Henry, T.J. Tut, M. Galloway, *et al.*, "Surface modification of poly (methyl methacrylate) used in the fabrication of microanalytical devices," *Anal Chem*, vol. 72, pp. 5331-5337, 2000.
- [23] T.M. Long, S. Prakash, M.A. Shannon, *et al.*, "Water-vapor plasma-based surface activation for trichlorosilane modification of PMMA," *Langmuir*, vol. 22, pp. 4104-4109, 2006.
- [24] C. Yuen, R. Williams, M. Batterbury, and I. Grierson, "Modification of the surface properties of a lens material to influence posterior capsular o-pacification," *J. Clinical and Experimental Ophthalmology*, vol. 34, pp 568-574, 2006.

زیرنویس‌ها

-
- ^۱ Hot Embossing
^۲ Laser ablation
^۳ Lab on a Module
^۴ Micro-Total Analyzing Systems (μTAS)
^۵ Deep Reactive Ion Etching
^۶ Aspect ratio
^۷ Spin coating
^۸ Dehydrated
^۹ Prebake
^{۱۰} Post exposure bake
^{۱۱} Crosslink
^{۱۲} Glass transition temperature
^{۱۳} Spin coater
^{۱۴} Alignment
^{۱۵} De-embossing
^{۱۶} Scanning Electron Microscope
^{۱۷} Vacuum ultraviolet (VUV) irradiation with exciter lamp
^{۱۸} Amino-Lysis
^{۱۹} Water-vapor plasma treatment
^{۲۰} Plasma aching
^{۲۱} Fidelity